

沖電気の半導体事業売却を厳しく問う

「いまでも過去も同様に、半導体事業を支え働く社員の姿。かつて事業の維持（リストラ）に涙して身を引いた社員のいたことを、あなたの心には存在しないのですか」

半導体事業は沖電気の基幹となる事業（屋台骨）の一つです。事業の売却を沖電気は強引に決めましたが、働くものの立場から、この施策を検討します。

<大まかな経緯>

78年の「合理化」以降 電電依存からデバイス生産に傾斜した経営陣。

歴代社長は、半導体を柱にして経営を行ってきたが、1998年就任の篠塚社長からデバイスからの脱皮を模索、迷走していたが、経営陣は、08年5月にローム社への売却を発表した。

1977年 電電公社からNO.3の三宅正男氏を福社長として迎える 電子デバイス事業部設立。

1978年 三宅氏社長に就任 社長室設立

当時沖電気は、NEC、富士通の遅れをとっているばかりでなく、国家プロジェクト「大規模集積回路開組合」（予算規模700億円）からは外されていて、経営の「非常事態」であった。このときの方針が今日までの沖電気の半導体の進路をきめている。（三宅社長は、密かに電電公社が開発したばかりの64キロビットの超LSI技術を沖電気は無償提供という隠し玉を持っていた）

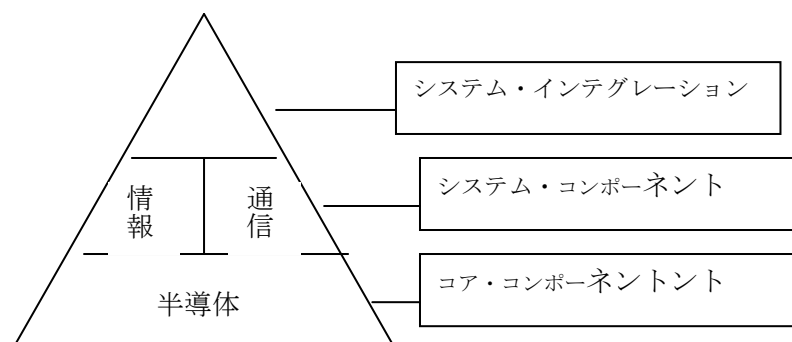
78年合理化の3本柱からそのことが読める

- ①1500人の首切り
- ②品川工場の電電公社への売却
- ③宮崎にIC工場（100億円以上）

—単なる電話屋からの脱皮を計画した三宅社長の発言—

「半導体部門の強弱が、今後のエレクトロニクス関連メーカーの消長を決める。半導体は自動車で言えば、エンジン、これをやらなきゃボデーメーカーになってしまう」

ここから、本格的な半導体製造がスタート



1997年当時の三層構造

このときのデバイス担当が

*篠塚勝正氏。

沢村社長「半導体を基礎にした会社運営が理想」当時の沖電気はメモリ（DRAM）が半分、半分がロジック。

< 1997年の基本方針でも、方針は半導体を基礎にした会社運営 >

1997年	1984. 4	橋本南海男社長（沖高崎・データ機器事業出身）
1986. 6		小杉信光社長（沖・電電営業出身）
1992. 10		神宮寺 順社長（電電公社出身）
1995. 8		沢村 紫光社長（沖・電子デバイス営業出身）
1998. 6		篠塚 勝正社長（沖。情報コンピュータ開発出身）
	1992年から	専務取締役

◎先端汎用DRAMからの撤退を方針の1番に据えた。ここから新しい沖を作るとして、船出した。

篠塚体制は、2007年一就任9年を経て、半導体部門の舵取りの正念場を迎えた。

< 半導体事業の主なできごと >

- ・1961年 6月 八王子事業所でデバイス生産を始める。
- ・1971年 八王子に開発本部設立
- ・1976年 VLSIの開発着手
- ・1980年 宮崎沖電気設立（84年にM2棟完工・200億円）
- ・1988年 宮城沖設立
- ・1990年 タイに半導体製造工場設立、八王子U棟環境アセス事件
- ・1998年 八王子のATP生産部門が宮城、宮崎に再編、
- ・2000年 マスク部門がHOYA社に譲渡
- ・2002年 技、設、製造の分離によりOCC発足
- ・2005年 TIのドライバLSI買収
- ・2006年 U1棟収束

***** 07年3月20日 マスコミが報じた 篠塚社長の発言です。*****

沖電気、営業利益率 3%以下の事業は収束を検討

（78年以来の半導体部門の見直しが本格的に開始される）

沖電気工業は経営説明会を開き、業績のV字回復に向けて事業や人員の整理を進めることを明らかにした。過去2年間のうち、一度でも売上高営業利益率が3%以下になった事業については、他の事業との統廃合や分社化、売却など、事業の収束を検討するという。事業の整理に伴って1200人を

異動させ、500 人を削減する(2006 年 3 月時点での総従業員数は約 5500 人)。具体的には、収束する事業から今後力を注ぐ事業へ 700 人を社内で異動させる。NGN(next generation network)に向けた通信インフラ事業や ATM(現金自動預け払い機)などの金融ビジネス事業が受け入れ先。この 700 人に加えて、グループ企業へ 500 人を出向または転籍させる。一方、500 人の削減は、同社の転職支援制度「Safety Placement」を利用して行うと表明。

半導体分野では、2007 年度(2007 年 4 月～2008 年 3 月)に 500 人規模の人員異動または削減を予定していると発表。縮小の主な対象はシステム LSI や ASIC の事業である。こうした半導体単独の事業から軸足を移すのが、同社の実装技術やパッケージング技術を生かした「機能モジュール事業」と説明。同社が強みとする MCP(multi-chip package)や SiP(system in a package)といった「3 次元実装技術、ウエハーレベル CSP(chip scale package)技術などによって、モジュールを小型化・省電力化し、付加価値を高めて売り込んでいく」が方針とされた。

「大型 TFT 液晶パネル用のドライバ IC」についても強化する。収益力を高めて黒字化を目指す、分社化する可能性もあった。

沖電気は、「2007 年度は事業の削減や統合、人員整理、固定費の圧縮などの取り組みにより、営業利益を 80 億円以上の黒字にして V 字回復を目指す」との目標を掲げた。そして、同社の取締役社長兼 CEO の篠塚勝正氏は説明会で「結果を出すことで、信頼を取り戻したい」と説明した。

参考 半導体部門売上高営業利益率 07年 0.5%

08年 2.7%

〔2008 年 5 月 28 日 ローム社への半導体事業の譲渡を発表〕

ローム株式会社と沖電気工業株式会社との間の、半導体子会社株式の譲渡に関する基本合意について

沖電気工業株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:篠塚 勝正 以下、「OKI」といいます。)とローム株式会社(本社:京都市右京区 代表取締役社長:佐藤 研一郎 以下、「ローム」といいます。)は、OKI がその半導体事業(以下、「本件半導体事業」といいます。)を会社分割し、株式会社 OKI セミコンダクタ(仮称)に分社化したうえで、当該新設会社の発行済み株式の 95%相当をロームに株式譲渡することについて基本合意いたしました。本日開催の両社取締役会において決議し、基本合意に至りましたのでお知らせいたします。今後は、OKI の株主総会で本件半導体事業の分社化が承認されること等を条件に、正式契約を締結する予定です。と突然の発表。